

Комплексная среда сквозного проектирования электронных устройств

Руководство пользователя Гибко-жесткие печатные платы Март, 2025







Руководство пользователя

Внимание!

Права на данный документ в полном объёме принадлежат компании «ЭРЕМЕКС» и защищены законодательством Российской Федерации об авторском праве и международными договорами.

Использование данного документа (как полностью, так и частично) в какой-либо форме, такое как: воспроизведение, модификация (в том числе перевод на другой язык), распространение (в том числе в переводе), копирование (заимствование) в любой форме, передача форме третьим лицам, – возможны только с предварительного письменного разрешения компании «ЭРЕМЕКС».

За незаконное использование данного документа (как полностью, так и частично), включая его копирование и распространение, нарушитель несет гражданскую, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Компания «ЭРЕМЕКС» оставляет за собой право изменить содержание данного документа в любое время без предварительного уведомления.

Последнюю версию документа можно получить в сети Интернет по ссылке: www.eremex.ru/knowleage-base/delta-design/docs

Компания «ЭРЕМЕКС» не несёт ответственности за содержание, качество, актуальность и достоверность материалов, права на которые принадлежат другим правообладателям.

Обозначения ЭРЕМЕКС, EREMEX, Delta Design, TopoR, SimOne являются товарными знаками компании «ЭРЕМЕКС».

Остальные упомянутые в документе торговые марки являются собственностью их законных владельцев.

В случае возникновения вопросов по использованию программ Delta Design, TopoR, SimOne, пожалуйста, обращайтесь:

Форум компании «ЭРЕМЕКС»:<u>www.eremex.ru/society/forum</u>

Техническая поддержка E-mail: <u>support@eremex.ru</u>

Отдел продаж Тел. +7 (495) 232-18-64 E-mail: <u>info@eremex.ru</u> E-mail: <u>sales@eremex.ru</u>





Содержание

Гибко-жесткие печатные платы

1	Сокращения и значения	4
2	Материалы	4
2.1	Редактирование таблицы «Материалы»	6
3	Конфигуратор набора слоев и переходных отверстий	8
3.1	Формирование структуры слоев платы	9
3.2	Формирование переходных отверстий	15
4	Граница печатной платы	17
5	Область сгиба	20
6	3D-визуализация сгибов	26
7	Размещение компонентов на плате	28
8	DRC	31
9	Трассировка	33
9.1	Интерактивная трассировка	33
9.2	Переходные отверстия	34
10	Подготовка к производству	35
10.1	Создание слоя маски	35
10.2	Экспорт производственных файлов	36
11	Ограничения	40





Настоящий документ содержит описание функциональных возможностей системы Delta Design, применяемых при разработке конструкций гибких и гибкожестких печатных плат (ГЖПП).

1 Сокращения и значения

В настоящем документе используется перечень сокращений, представленный в <u>Табл. 1</u>.

Сокращение	Значение
DRC	Design Rule Checking (Проверка правил проектирования)
гжпп	Гибко-жесткая печатная плата
КП	Контактная площадка
ПО	Переходное отверстие
ТУ	Технические условия

Таблица 1. Перечень сокращений

2 Материалы

В Delta Design формирование структуры слоев печатной платы выполняется на основе имеющихся в системе материалов.

Общий список материалов доступен пользователю для редактирования.

Переход к редактору материалов осуществляется из панели «Стандарты» с узла «Материалы», см. <u>Рис. 1</u>.







Рис. 1 Панель «Стандарты»

В системе введено понятие – конструктивный элемент. В основе конструктивного элемента лежит слой, из которого формируется вся наборная конструкция печатной платы. Также конструктивный элемент может представлять собой базовую заготовку (основу), на основании которой производитель создает весь пакет печатной платы.

Подробнее о типах базовых заготовок и их характеристиках можно узнать на сайте производителя печатных плат.

В редакторе «Материалы» информация отображается в виде таблицы со следующими столбцами:

- Конструктивный элемент;
- Тип материала;
- Материал;
- Гибк. (Гибкость);
- Толщина (мм);
- Диэлектрическая проницаемость;
- Проводимость;
- Температура;
- ТУ;
- Производитель.





Внешний вид редактора материалов представлен на рисунке, см. Рис. 2.

<i>i</i> Материалы 🛛 🕹									
⊕∽↑↓⊝[ᡛ									
Конструктивный элемент	Тип материала	Материал	Гибк.	Толщина (мм)	Диэлектрическая пр	Проводимость	Температура	ту	Производите
Маска	Эпоксидная смола с	Жидкая маска Зеленая Матов		0,015	3,5				-
Маска	Сухой плёночный фо	Сухая плёночная маска Глянц		0,04	3,56				
Маска	Сухой плёночный фо	Сухая плёночная маска Глянц		0,1	3,56				
Маска	Полиимидная пленка	(flex)LF0210 (IPC-4203/1) PI 0,		0,075	3,6				
Маска	Полиимидная пленка	(flex)LF0110 (IPC-4203/1) PI 0,	\checkmark	0,05	3,6				
Препрег	Стеклоткань	FR4(Tg150) тип 1080		0,076	4,1				
Препрег	Стеклоткань	FR4(Tg150) тип 2116		0,125	4,1				
Препрег	Стеклоткань	FR4(Tg150) тип 7628		0,18	4,1				
Препрег	Стеклоткань	Arlon-49N тип 106 50мкм		0,05	4,4				
Препрег	Стеклоткань	Arlon-49N тип 1080 75мкм		0,075	4,4				
Фольга	Медь	Медь 18мкм	\checkmark	0,018		59 500 000			
Фольга	Медь	Медь 35мкм		0,035		59 500 000			
Фольга	Медь	Медь 70мкм	✓	0,07		59 500 000			
Основа	Стеклотекстолит	FR4(Tg150) Ядро:0.2мм		0,2	4,3				
Основа	Стеклотекстолит	FR4(Tg150) Ядро:1.13мм		1,13	4,3				
	Медь		\checkmark	0,018		59 500 000			
Основа	Стеклотекстолит	FR4(Tg150) IPC-4101/99 Ядро:		0,2	4,1				
	Медь			0,018		59 500 000			
	Медь			0,035		59 500 000			
Основа	Стеклотекстолит	FR4(Tg150) IPC-4101/99 Ядро:1		1,13	4,6				
	Медь		\checkmark	0,035		59 500 000			
Основа	Алюминий	Алюминий Ядро:1мм		1		35 000 000			
Основа	Полиимид	(flex)Полиимид Ядро:0.25мм	\checkmark	0,25	3,6				
0	Медь	((1-1)) 505400 ((00-4004)) 7	\checkmark	0,018		59 500 000			
ОСНОВА	Полиимид	(пех)LF8510к (IPC-4204/1) Яд	\checkmark	0,05	3,6				
	Медь		\checkmark	0,018		59 500 000			

Рис. 2 Редактор материалов

Перечень конструктивных элементов сформирован с учетом возможности создания гибких и гибко-жестких печатных плат.

Представленные в таблице материалов конструктивные элементы доступны для выбора и использования при создании конфигурации набора слоев печатных плат, используемых в проекте.

Для выделения материалов, применяемых при создании конструкции гибких и гибко-жестких плат, в таблице материалов включен специальный столбец «Гибкость».

Система автоматически ставит флаг в этом столбце для конструктивных элементов, материалы которых могут применяться в гибкой части.

К таким конструктивным элементам относятся элементы («Фольга», «Маска», «Основа»), у которых в качестве материала выбраны «Медь», «Полиимид» или «Полиимидная пленка».

2.1 Редактирование таблицы «Материалы»

Для добавления доступны следующие типы конструктивных элементов:

- Препрег (диэлектрик);
- Фольга (медь);





• Маска (покрытие платы).

Для добавления также доступны комбинации конструктивных элементов (заготовок):

- Фольга + Основа;
- Основа + Фольга;
- Фольга + Основа + Фольга;
- Основа (диэлектрик);
- Основа (металл).

Добавление конструктивного элемента

1. Нажмите кнопку редактора.

🕀 , расположенную в верхней части окна

2. В выпадающем списке выберите конструктивный элемент, см. Рис. 3.



3. В поле «Тип материала» из выпадающего списка выберите материал добавленного конструктивного элемента, см. <u>Рис. 4</u>.

Конструктивный элем	Тип материала	Материал	Гибк.	Толщина (мм)	Диэлектрическая про	Проводимость	Температ	ту	Производитель
Основа	Стеклотекстолит	Arlon 92 ML 106 90 0,107		0,107					Резонит
Основа	Стеклотекстолит	LF0111 PI 0,025 Ad 0,025-0,025		0,075	3,6		280		Резонит
Основа	Стеклотекстолит	IT-180 1080		0,106					Резонит
Основа	Стеклотекстолит	FSD350PP 0,102		0,102					Резонит
Основа	Стеклотекстолит	WL-PP350 0,102		0,102	3,5		280		Резонит
Основа	Стеклотекстолит	WL-PP300 0,102		0,102	3		280		Резонит
Основа	Стеклотекстолит	TU-1400P 1078 R/C73%		0,1	3,14		170		Резонит
Основа	Стеклотекстолит	TU943P 1078 RC66 %		0,076	3,24				Резонит
Основа	Стеклотекстолит	TU943P 1078 RC74 %		0,102	3,14				Резонит
Основа	Медь	Core Aluminum	\checkmark	0,018		35 000 000			

Рис. 4 Выбор материала





- 4. Заполните поле «Материал» и прочие параметры материала, параметр «Гибкость» проставляется системой автоматически при выборе материалов «Медь», «Полиимид» и «Полиимидная пленка».
- 5. Сохраните изменения, нажав «Сохранить» или «Сохранить все» на панели инструментов «Общие», см. <u>Рис. 5</u>.

Общие	\times
	\rightarrow
Сохранить Ctrl+S Puc. 5 Сохранени изменений	е

Перемещение конструктивных элементов в таблице

1. Выберите в списке конструктивный элемент, который необходимо переместить.

2. Нажмите кнопку 📫, расположенную в верхней части окна редактора,

для перемещения конструктивного элемента вверх или нажмите кнопку 💛 для перемещения вниз.

3. Сохраните изменения, нажав «Сохранить» или «Сохранить все» на панели инструментов «Общие», см. <u>Рис. 4</u>.

Удаление конструктивного элемента

- 1. Выберите в списке конструктивный элемент, который необходимо удалить.
- 2. Нажмите кнопку Θ , расположенную в верхней части окна редактора.
- 3. Сохраните изменения, нажав «Сохранить» или «Сохранить все» на панели инструментов «Общие», см. <u>Рис. 3</u>.

3 Конфигуратор набора слоев и переходных отверстий

Работа со слоями печатной платы выполняется в окне «Конфигуратор набора слоев и переходных отверстий» (далее – редактор слоев). Переход в данный редактор осуществляется из контекстного меню узла «Плата» в дереве проекта с помощью команды «Слои и переходные отверстия», см. <u>Рис. 6</u>.







Рис. 6 Переход в редактор слоев

Редактор слоев позволяет создавать стеки (наборы слоев), описывающие отдельно гибкую и отдельно жесткую часть печатной платы. Также в редакторе есть возможность формировать переходные отверстия для каждого стека платы.

3.1 Формирование структуры слоев платы

Формирование слоев платы выполняется на вкладке «Структура» редактора слоев платы. Внешний вид окна редактора платы с раскрытой вкладкой «Структура» представлен на <u>Рис. 7</u>.

C	труктура Документирующие	слои Переходные отве	рстия	Калькулятор и Кал	импеданса						MM
9	1 🕂 🗯 🐔 🐴 🖻	Производитель: <Все:	>	~							
	Конструктивный элемент	Материал	N ^g	Тип слоя	Класс слоя	Имя	Цвет	Толщина		Стеки	
									Rigid	Flex	Flex2
									Жесткий	Гибкий	Гибкий
									Используется	Используется	Используется
	Маска	Жидкая маска Зелен				SOLDERMASK		0,015			
	Фольга	Медь 18мкм	1	Сигнальный	SIGNAL_INTERNAL	L1	-	0,018			
	Препрег	FR4(Tg150) тип 1080						0,076	<u> </u>		
	Фольга	Медь 18мкм	2	Сигнальный	SIGNAL_INTERNAL	Signal 1	-	0,018			
2	Препрег	FR4(Tg150) тип 1080						0,076	~		
	Маска	(flex)LF0110 (IPC-420				Покровная_ТОР		0,05			
			3	Сигнальный	SIGNAL_INTERNAL	L2(flex)		0,018		~	
	Основа	(flex)AG182518R (IPC						0,025		~	
			4	Сигнальный	SIGNAL_INTERNAL	L3(flex)		0,018			
	Препрег	FR4(Tg150) тип 1080						0,076	_		
	Маска	(flex)LF0110 (IPC-420				Покровная_ВОТ		0,05			
			5	Сигнальный	SIGNAL_INTERNAL	Signal 2		0,018			
	Основа	(flex)AG182518R (IPC						0,025	_		
			6	Сигнальный	SIGNAL_INTERNAL	Signal 3		0,018			
	Маска	(flex)LF0210 (IPC-42				Coverlay1		0,075			
	Препрег	FR4(Tg150) тип 1080						0,076	_		
	Фольга	Медь 18мкм	7	Сигнальный	SIGNAL_INTERNAL	Signal 4		0,018			
	Препрег	FR4(Tg150) тип 1080						0,076	 	*****	******
	Фольга	Медь 18мкм	8	Сигнальный	SIGNAL_INTERNAL	Signal 5	-	0,018			
	Маска	Жидкая маска Зелен				SOLDERMASK		0,015			
			8					0.779	0.779 MM	0.779 MM	0.779 MM

Рис. 7 Окно редактора слоев. Вкладка «Структура»

Конструктивные элементы платы





Добавление новых конструктивных элементов (слоев) платы происходит в таблице слоев. Для этого переместите курсор в крайний левый столбец, далее переместите курсор между соответствующими элементами из уже присутствующего списка конструктивных элементов и нажмите на символ \oplus , см. <u>Рис. 8</u>.

4	труктура документи	ф 🤌 Производите	ходнь эль:	«Все»	кулятор импеданса						MM
-	Конструктивный	Материал	N ²	Тип слоя	Класс слоя	Имя	Цвет	Толщина		Стеки	
									Rigid	Flex	Flex2
									Жесткий	Гибкий	Гибки
									Используется	Используется	Использу
	Маска	Жидкая маска Зе				SOLDERMASK_TOP		0,015			
	Фольга	Медь 18мкм	1	Сигнальный	SIGNAL_INTERNAL	LI	-	0,018	✓		
	Препрег	FR4(Tg150) тип 1						0,076	<u>~</u>		
	Фольга	Медь 18мкм	2	Сигнальный	SIGNAL_INTERNAL	Signal 1		0,018			
æ	Пpenper	FR4(Tg150) тип 1						0,076	N		
0		(flex)AG182518R (I	3	Сигнальный	SIGNAL_INTERNAL	L2(flex)		0,018			
	Основа							0,025			
			4	Сигнальный	SIGNAL_INTERNAL	L3(flex)		0,018			
	Препрег	FR4(Tg150) тип 1						0,076	✓		
	Маска	(flex)LF0110 (IPC				Покровная_ВОТ		0,05			
		(flex)LF0110 (IPC	5	Сигнальный	SIGNAL_INTERNAL	Signal 2		0,018			
	Основа	(flex)AG182518R (I						0,025			
			6	Сигнальный	SIGNAL_INTERNAL	Signal 3		0,018			
	Маска	(flex)LF0210 (IPC				Coverlay1		0,075			
	Препрег	FR4(Tg150) тип 1						0,076			
	Фольга	Медь 18мкм	7	Сигнальный	SIGNAL_INTERNAL	Signal 4		0,018			
	Препрег	FR4(Tg150) тип 1						0,076			******
	Фольга	Медь 18мкм	8	Сигнальный	SIGNAL_INTERNAL	Signal 5		0,018			
	Маска	Жидкая маска Зе				SOLDERMASK_BO		0,015			
			8					0,729	0,729 MM	0,729 MM	0,729 M

Рис. 8 Добавление конструктивного элемента платы

В выпадающем меню выберите один из представленных конструктивных элементов или заготовок, см. <u>Рис. 9</u>.

	Конструктивный	Матери	ал	Nº	Тип слоя	Класс слоя	Имя
	Маска	Жилкая мас	каЗе				SOLDERMASK TOP
	Фольга	Медь 18мкм	1	1	Сигнальный	SIGNAL_INTERNAL	L1
	Препрег	FR4(Tg150)	тип 1				
	Фольга	Медь 18мкм	I.	2	Сигнальный	SIGNAL_INTERNAL	Signal 1
	Препрег	FR4(Tg150)	тип 1				
Ð	Фольга	-		3	Сигнальный	SIGNAL_INTERNAL	L2(flex)
	Препрег		18R (I				
	Фольга + Основа +	Фольга		4	Сигнальный	SIGNAL_INTERNAL	L3(flex)
	Фольга + Основа		ип 1				
	Основа + Фольга		IPC				Покровная_ВОТ
	Основа (диэлектри	ик)		5	Сигнальный	SIGNAL_INTERNAL	Signal 2
	Основа (металл)	Основа (металл)					
	Маска	Маска			Сигнальный	SIGNAL_INTERNAL	Signal 3
	Маска	(flex)LF0210	(IPC				Coverlay1

Рис. 9 Выбор конструктивного элемента





В выпадающем списке выберите материал добавленного конструктивного элемента, см. Рис. 10.

	Препрег	FR4(Tg150) тип	1					
æ	Маска	Жидкая мас	~				Coverlay2	
U		Жидкая маска 3	Зелен	ная М	атовая XV-501T LDI (0	,015мм) (Er=3,5)		
	Основа	Сухая плёночна	я ма	ска Г	лянцевая Зелёная DYI	NAMASK 5000 40мкм (0,04мм) (Er=3,56)	
		Сухая плёночна	я ма	ска Г	лянцевая Зелёная DYI	NAMASK 5000 100мкм	(0,1мм) (Er=3,56)	
	Препрег	(flex)LF0210 (IP	0-42	03/1)	PI 0,025; Ad 0,050 (0,0	75мм) (Er=3,6)		
	Маска	(flex)LF0110 (IPC	C-420	03/1)	PI 0,025; Ad 0,025 (0,0	5мм) (Er=3,6)		

Рис. 10 Выбор материала



Примечание! Система автоматически выполняет онлайн-проверку корректности формирования стека. При наличии нарушений в нижней части окна редактора отображается предупреждающий символ **!**. Наведите курсор на иконку для раскрытия описания выявленных нарушений, см. <u>Рис. 11</u>.

0,076 ✓ ✓ ■ 0,018 ✓ ● 1 0,015 ✓ ● 0,804 0,804 мм 0,804 мм 0,804 мм	0,018			
Image: 0,018 Image: 0,015 Image: 0,015 Image: 0,016 Image: 0,016	0,076	~		
0,015 ✓ □ 0,804 0,804 MM 0,804 MM 0,804 MM	0,018			
0,804 0,804 mm 0,804 mm 0,804 mm	0,015			
	0,804	0,804 мм	0,804 мм	0,804 мм
			В стеке	е: "Flex" два или более в е: "Flex2" два или более

Рис. 11 Отображение выявленных нарушений

Введите с клавиатуры название слоя, см. Рис. 12.

Конф	игуратор набора слоев	и переходных отверс	тий								- 🗆 ×
(Структура Документи	ирующие слои Пере	ходн	ые отверстия Калы	кулятор импеданса						MM ~
1	i 🕇 🕂 💐 💐	🐴 🥟 Производит	ель:	<bce></bce>	~						
	Конструктивный	Материал	Nº	Тип слоя	Класс слоя	Имя	Цвет	Толщина		Стеки	
									Rigid	Flex	Flex2
									Жесткий	Гибкий	Гибкий
									Используется	Используется	Используется
(+	Маска	Жидкая маска Зе				SOLDERMASK_TOP		0,015			
	Фольга	Медь 18мкм	1	Сигнальный	SIGNAL_INTERNAL	u	-	0,018	 ✓ 		
	Препрег	FR4(Tg150) тип 1						0,076	2		
	Фольга	Медь 18мкм	2	Сигнальный	SIGNAL_INTERNAL	Signal 1		0,018	 ✓ 		
	Препрег	FR4(Tg150) тип 1						0,076	~		
	Маска	(flex)LF0210 (IPC				Покрывная_ТОР		0,075			
			3	Сигнальный	SIGNAL_INTERNAL	L2(flex)		0,018	 ✓ 		
	Основа	(flex)AG182518R (0,025	Z		
			4	Сигнальный	SIGNAL_INTERNAL	L3(flex)		0,018			

Рис. 12 Переименование слоя

Для использования добавленного конструктивного элемента в стеке печатной платы установите флаг в соответствующем столбце таблицы, см. Рис. 13.







Важно! Для гибких стеков допустимо использовать конструктивные элементы, обладающие свойством «Гибкость».



Примечание! По умолчанию материалы, доступные для использования в гибком стеке печатной платы имеют дополнение «(flex)» перед названием. Материалы, используемые в жесткой части платы, по умолчанию такого дополнения не имеют.

Конфи	гуратор набора слоев	и переходных отверс	гий								- 🗆 ×
С	труктура Документи	прующие слои Пере	ходнь	ые отверстия Кальк	улятор импеданса						мм ~
4	1 I 🗸 🔹	🥎 🥐 Производит	ель:	<bce></bce>	~						
	Конструктивный	Материал	Nº	Тип слоя	Класс слоя	Имя	Цвет	Толщина		Стеки	
									Rigid	Flex	Flex2
									Жесткий	Гибкий	Гибкий
									Используется	Используется	Используется
	Маска	Жидкая маска Зе				SOLDERMASK_TOP		0,015			
	Фольга	Медь 18мкм	1	Сигнальный	SIGNAL_INTERNAL	L1	-	0,018	✓		
	Препрег	FR4(Tg150) тип 1						0,076	~		
	Фольга	Медь 18мкм	2	Сигнальный	SIGNAL_INTERNAL	Signal 1		0,018	<		
	Препрег	FR4(Tg150) тип 1						0,076	~		
	Маска	(flex)LF0210 (IPC				Покрывная_ТОР		0,075			
			3	Сигнальный	SIGNAL_INTERNAL	L2(flex)		0,018	 ✓ 		
	Основа	(flex)AG182518R (0,025	~		
			4	Сигнальный	SIGNAL_INTERNAL	L3(flex)		0,018			

Рис. 13 Использование конструктивного элемента в гибком стеке

В таблице отображена информация о конструктивных элементах платы, сгруппированная по столбцам:

- Материал материал, заданный для конструктивного элемента (слоя).
- Номер (№) номер проводящего слоя. Нумерация начинается от верхнего проводящего слоя платы.
- Тип слоя указание типа проводящего слоя (сигнальный или опорный). Тип проводящего слоя выбирается с помощью выпадающего списка. Для слоя «Опорный» доступен выбор цепи, при наличии в проекте.
- Класс слоя выбор внутреннего сигнального класса слоя. Создание новых внутренних сигнальных классов слоев производится в панели «Стандарты» → «Классы слоев».
- Имя имя (название) проводящего слоя используется в редакторе платы при выборе слоя для трассировки. Имя слоя должно быть уникальным. Введенное имя слоя будет отображаться на плате.
- Цвет цвет, которым отображаются на плате элементы печатного монтажа (проводники, зоны металлизации), расположенные на данном слое.
- Толщина толщина слоя платы, задается при создании конструктивного элемента в разделе «Материалы».







Примечание! Материал и тип проводящего слоя выбираются с помощью выпадающего списка. Имя слоя вводится с помощью клавиатуры в соответствующих полях.

В верхней части вкладки «Структура» расположена контекстнозависимая панель инструментов редактирования слоёв и стеков, описание инструментов представлено в <u>Табл. 2</u>.

Таблица 2. Описание инструментов редактирования слоев и стеков

Вид	Название	Описание
-	Удалить слой	Кнопка становится активной при выборе слоя. Нажатие на кнопку удаляет выбранный слой.
Ť	Вверх	Кнопка становится активной при выборе слоя (кроме самого верхнего слоя в таблице). Нажатие на кнопку перемещает выбранный слой вверх в общей таблице слоев.
Ŧ	Вниз	Кнопка становится активной при выборе слоя (кроме самого нижнего слоя в таблице). Нажатие на кнопку перемещает выбранный слой вниз в общей таблице слоев.
*	Новый стек	Кнопка находится в активном состоянии. Нажатие на кнопку добавляет новый стек.
-	Удалить стек	Кнопка становится активной при выборе стека. Нажатие на кнопку удаляет выбранный стек.
*	Отменить действие	Кнопка становится активной после выполнения какого- либо действия. Нажатие на кнопку отменяет последнее действие.
\$	Выполнить вновь	Кнопка становится активной после применения команды «Отменить действие». Нажатие на кнопку повторяет отмененное действие.

Стеки

Добавление стека осуществляется по нажатию соответствующей кнопки, описание кнопок представлено в <u>Табл. 2</u>.

При добавлении нового стека, он отобразится в правой части таблицы редактора слоев в столбце «Стеки», см. <u>Рис. 14</u>.





Структура Документир	рующие слои Переход	цные (отверстия Калькуля	тор импеданса							
s 🕇 🕂 🗸 📽 🧐	🏷 🤌 Производитель	< <	Bce> ~								
Конструктивный э	Материал	N⁰	Тип слоя	Класс слоя	Имя	Цвет	Толщина (мм)	Стек468	Стек1458	Стек3151	Стек5079
								Rigid	Flex	Flex2	New Stackup
								Жесткий	Гибкий	Гибкий	Жесткий
								Используется	Используется	Используется	Не используе
Маска	Жидкая маска Зел				SOLDERMASK_TOP		0,015				
Фольга	Медь 18мкм	1	Сигнальный	SIGNAL_INTERNAL	L1	-	0,018				
Пpenper	FR4(Tg150) тип 1080						0,076	2			~
Фольга	Медь 18мкм	2	Сигнальный	SIGNAL_INTERNAL	Signal 1		0,018				
Препрег	FR4(Tg150) тип 1080						0,076	2			
Маска	(flex)LF0110 (IPC-4				Покровная_ТОР		0,05				
		3	Сигнальный	SIGNAL_INTERNAL	L2(flex)		0,018				
Основа	(flex)AG182518R (IP						0,025				
		4	Сигнальный	SIGNAL_INTERNAL	L3(flex)		0,018				
Npenper	FR4(Tg150) тип 1080						0,076	~			
Маска	(flex)LF0110 (IPC-4				Покровная_ВОТ		0,05				
		5	Сигнальный	SIGNAL_INTERNAL	Signal 2		0,018				
Основа	(flex)AG182518R (IP						0,025				
		6	Сигнальный	SIGNAL_INTERNAL	Signal 3		0,018				
Маска	(flex)LF0210 (IPC-4				Coverlay1		0,075				
Препрег	FR4(Tg150) тип 1080						0,076				
Фольга	Медь 18мкм	7	Сигнальный	SIGNAL_INTERNAL	Signal 4		0,018				
Пpenper	FR4(Tg150) тип 1080						0,076				
Фольга	Медь 18мкм	8	Сигнальный	SIGNAL_INTERNAL	Signal 5		0,018				
Маска	Жидкая маска Зел				SOLDERMASK_BOT		0,015				
		8					0,779	0,604 MM	0,161 MM	0,186 мм	0,779 мм

Рис. 14 Отображение нового стека

Название стека задается в верхней строке соответствующего столбца. Для переименования стека необходимо кликнуть левой клавишей мыши в поле и ввести название с клавиатуры, см. <u>Рис. 15</u>.

					- 🗆 ×
Цвет	Толщина (мм)	Стек468	Стек1458	Стек3151	Стек5079
		Rigid	Flex	Flex2	Новый стек
		Жесткий	Гибкий	Гибкий	Жесткий
		Используется	Используется	Используется	Не используется
	0,015				
-	0,018				
	0,076				
	0,018				
	0,076				
		Рис. 15 Пере	еименование	стека	

Изменение типа стека осуществляется в выпадающем меню, см. Рис. 16.





					- 0
Цвет	Толщина (мм)	Стек468	Стек1458	Стек3151	Стек5079
		Rigid	Flex	Flex2	Новый стек
		Жесткий	Гибкий	Гибкий	Жесткий
		Используется	Используется	Используется	Жесткий
	0,015				Гибкий
-	0,018				
	0,076	<u> </u>			<u> </u>
	0,018				
	0,076	<u> </u>			<u>_</u>

Рис. 16 Изменение типа стека



Примечание! При изменении типа стека с жесткого на гибкий конструктивные элементы, не обладающие свойством «Гибкость», будут исключены из стека.

3.2 Формирование переходных отверстий

Определение типов переходных отверстий выполняется во вкладке «Переходные отверстия». Вкладка может содержать внутренние вкладки, каждая из которых будет соответствовать отдельному стеку, созданному на вкладке «Структура». По умолчанию на вкладке отображается один стиль переходных отверстий для стека. Внешний вид окна представлен на <u>Рис. 17</u>.



Рис. 17 Окно редактора слоев. Вкладка «Переходные отверстия»





В верхней части окна расположена контекстно зависимая панель инструментов редактирования стилей переходных отверстий, описание инструментов представлено в <u>Табл. 3</u>.

Таблица 3. Описание инструментов редактирования стилей ПО	
---	--

Вид	Название	Описание
÷	Добавить новый стиль	Кнопка находится в активном состоянии. Нажатие на кнопку добавляет новый стиль.
Û	Удалить стиль	Кнопка становится активной при выборе стиля. Нажатие на кнопку удаляет стиль.
\leftarrow	Сдвинуть влево	Кнопка становится активной при выборе стиля. Нажатие на кнопку перемещает выбранный стиль влево в общей таблице.
\rightarrow	Сдвинуть вправо	Кнопка становится активной при выборе стиля. Нажатие на кнопку перемещает выбранный стиль вправо в общей таблице.
¢	Отменить действие	Кнопка становится активной после выполнения какого- либо действия. Нажатие на кнопку отменяет последнее действие.
<i>(</i> *	Выполнить вновь	Кнопка становится активной после применения команды «Отменить действие». Нажатие на кнопку повторяет отмененное действие.

Доступные настройки переходных отверстий:

- Название стиля имя, под которым в проекте будет использоваться данный тип переходного отверстия.
- Кол-во использований количество размещенных переходных отверстий в проекте печатной платы.
- Со слоя слой, с которого осуществляется переход. Выбор стартового слоя осуществляется с помощью выпадающего списка. Слои указываются от верхнего проводящего слоя платы, нижний проводящий слой в списке отсутствует.
- На слой слой, на который осуществляется переход. Выбор конечного слоя осуществляется с помощью выпадающего списка. Слои указываются от нижнего проводящего слоя платы, верхний проводящий слой в списке отсутствует.
- Диаметр отверстия диаметр переходного отверстия.





- Диаметр КП на начальном слое внешний диаметр контактной площадки переходного отверстия на слое, с которого «начинается» межслойный переход.
- Диаметр КП на промежуточных слоях внешний диаметр контактной площадки переходного отверстия на внутренних проводящих слоях.
- Диаметр КП на конечном слое внешний диаметр контактной площадки переходного отверстия на слое, где «заканчивается» межслойный переход.

4 Граница печатной платы

Для создания границ печатной платы реализован набор инструментов, доступный в главном меню программы «Инструменты» → «Граница платы», см. <u>Рис. 18</u>.



Рис. 18 Меню «Инструменты» → «Граница

Также данный набор инструментов доступен на панели инструментов «Плата», см. <u>Рис. 19</u>.



Рис. 19 Панель инструментов «Плата»





Выбор любого из трех инструментов: «Задать границу платы: прямоугольник», «Задать границу платы: окружность» и «Задать границу платы: многоугольник» осуществит автоматический переход на слой BOARD_OUTLINE в графическом редакторе платы.

Пример отображения созданной границы платы представлен на Рис. 20.



Рис. 20 Контур платы

После создания контура платы необходимо выбрать стек для созданного участка платы. По умолчанию присваивается первый стек из таблицы редактора слоев.

Есть возможность выбрать стек и до создания границ платы, для этого после выбора инструмента «Границы платы» необходимо выбрать стек в меню «Свойства», и затем создать границы.

Выбор стека осуществляется в панели «Свойства».

Для просмотра свойств созданного контура выделите контур и выберите «Свойства» в контекстном меню, см. <u>Рис. 21</u>.







Рис. 21 Переход к свойствам объекта

Выбор стека осуществляется в панели «Свойства» в выпадающем меню «Стек», см. <u>Рис. 22</u>.

🔄 Свойства		
Граница платы (Прямоугольник)	
Q Поиск		
🗸 Печатная плата		
Слой	BOARD_OUTLINE	~
🗸 Общие		
Стек	Rigid	~
Тип стека	Flex	
∨ Настройки	Rigid	
Зафиксировано		
√ Геометрия		
Контур	Прямоугольник	
> Расположение	0; 0	
> Размер	20; 20	
> Центр	10; 10	
Выделен	1 объект	

EREMEX



При создании контура платы, содержащего два и более стеков и состоящего из нескольких простых контуров, границы созданных контуров должны прилегать друг к другу.

Для каждого контура созданной границы печатной платы необходимо выбрать стек в зависимости от назначения созданного участка платы.

Пример отображения контура печатной платы, состоящего из трёх простых контуров, представлен на <u>Рис. 23</u>.



Рис. 23 Сложный контур платы

При создании проекта жесткой платы создание контура печатной платы осуществляется стандартным способом. Описание данного процесса представлено в документе <u>Редактор печатных плат</u>.

5 Область сгиба

В системе Delta Design работа создание области сгиба платы начинается с запуска специализированного инструмента «Разместить линию сгиба».



Важно! Линия сгиба – это проекция оси цилиндра, по поверхности которого осуществляется сгиб гибкой части платы, см. <u>Рис. 24</u>.







Рис. 24 Схематичное представление области сгиба

Инструмент доступен в главном меню программы «Инструменты» → «Граница платы» → «Разместить линию сгиба», см. <u>Рис. 25</u>.

Ин	струменты				
₩	Проверка платы (DRC)				
\mathbb{C}	Обновление компонентов				
P	SimPCB				
69	Поиск объектов	Ctrl+F			
	Фанауты		>		
	Граница платы		>	<u> </u>	адать границу платы: прямоугольник
	Область металлизации		>	<u>o</u> 3	Задать границу платы: окружность
	Регион		>	<u>89</u> 3	адать границу платы: многоугольник
<u></u>	Заменить маску и пасту				вырезать из платы прямоугольник
\frown	Натяжение треков	F5		Ö E	Зырезать из платы круг
	Скругление треков			E E	врезать из платы многоугольник
	Удалить трассировку			D F	Разместить линию сгиба
	Сохранить как новый вариант платы			ģΓ	реобразовать в контур платы
<u>ut</u>	Статистика проекта			•	Отображать стеки границ платы
ſ	Измерить расстояние			V	1мпорт границы платы из DXF
0.41 404 1.41	Перенести	Μ			
tų	Переместить начало координат				

Рис. 25 Переход к размещению линии сгиба

Также данный инструмент доступен на панели инструментов «Плата», см. <u>Рис. 26</u>.

Плата	×
\$\$\$ □ □ □ □ □ □ □ □ □	🖬 🗸 💹 🖌 💭 🗸 🔕 🕵 🖻
	📰 Задать границу платы: прямоугольник
	🦉 Задать границу платы: окружность
	🔛 Задать границу платы: многоугольник
	🛅 Вырезать из платы прямоугольник
	🛱 Вырезать из платы круг
	🔛 Вырезать из платы многоугольник
	🗘 Разместить линию сгиба
	🏠 Преобразовать в контур платы
	Импорт границы платы из DXF
	🗐 Отображать стеки границ платы









Примечание! Линию сгиба необходимо размещать на участке платы, относящемуся к гибкому стеку платы.

После выбора инструмента «Разместить линию сгиба» переместите курсор мыши на границу гибкого участка платы и нажмите левую клавишу мыши, см. <u>Рис. 27</u>.



Рис. 27 Начало размещения линии сгиба

Далее переместите курсор мыши на противоположный участок платы и нажмите левую клавишу мыши, см. <u>Рис. 28</u>.



Рис. 28 Завершение размещения линии сгиба

После размещения линии сгиба инструмент «Разместить линию сгиба» остается активным.

Количество размещаемых сгибов не ограничено.

Для выхода из инструмента нажмите клавишу «Escape» или нажмите кнопку «Отменить», расположенную в правом верхнем углу окна редактора, см. <u>Рис. 29</u>.







Рис. 29 Выход из инструмента «Разместить линию сгиба»

После размещения линии сгиба на гибком участке гибко-жесткой конструкции будет сформирован новый объект - сгиб. При первом размещении сгибу задаются значения по умолчанию.

Для изменения параметров сгиба перейдите в свойства выделенного объекта, см. <u>Рис. 30</u>.



Рис. 30 Свойства сгиба

Для изменения доступны следующие параметры сгиба:





- Радиус единицы измерения радиуса сгиба зависят от выбранных в системе (мм или мил);
- Угол угол сгиба (градусы);
- Стек выбор стека, к которому относится сгиб, если на плате задействовано два и более гибких стеков;
- Зафиксировано при установке флага в чек-бокс перемещение сгиба будет недоступно.

Направление (направление создания) сгиба дает разный результат на 3D модели платы, изменение направления может быть произведено за счет поворота линии сгиба на 180°. Поворот линии сгиба осуществляется с помощью горячих клавиш «R» и «Shift+R». На <u>Рис. 31</u> и <u>Рис. 32</u> представлены примеры различных направлений сгиба при одинаковых параметрах, заданных в панели «Свойства».



Рис. 31 Направление сгиба «Слева направо»







Рис. 32 Направление сгиба «Справо налево»

При размещении сгиба важно помнить, что ось сгиба (центральная штриховая линия) должна быть расположена таким образом, чтобы не пересекать области платы, которые меняют свое положение при сгибе на 3D модели платы. На <u>Рис. 33</u> показан пример пересечения подвижной области (ось сгиба удлинена для наглядности), сгиб на 3D модели платы не может быть применен.



Рис. 33 Пересечение осью сгиба региона, меняющего положение при сгибе





Пересечение осью сгиба области, остающейся неподвижной, возможно. На <u>Рис. 34</u> показан пример пересечения неподвижной области (ось сгиба удлинена для наглядности), сгиб на 3D модели платы применен.



Рис. 34 Пересечение осью сгиба региона, не меняющего положение при сгибе

6 3D-визуализация сгибов

Для просмотра сгибов на 3D модели печатной платы перейдите в панель «Проекты» и в контекстном меню для узла «Плата» выберите «Открыть 3D модель», см. <u>Рис. 35</u>.







Рис. 35 Переход к 3D модели

При открытии 3D модели плата отображается без сгибов.

Для отображения сгибов печатной платы нажмите кнопку 🕅 «Отображать сгиб» на встроенной панели инструментов, см. <u>Рис. 36</u>.



Рис. 36 Переход к отображению сгиба

Сгибы будут отображены с заданными ранее параметрами, см. Рис. 37.







Рис. 37 Отображение сгиба

В случае если сгиб не может быть применен на 3D модели платы, в панели «Журналы» будет отображено информирующее сообщение, см. <u>Рис. 38</u>.



Рис. 38 Сообщение в панели «Журналы»

7 Размещение компонентов на плате

Описание процесса размещения компонентов на плате представлено в документе <u>Редактор печатных плат</u>.

При размещении компонента в областях гибко-жесткой платы стек контактных площадок размещенного компонента формируется на основе той области, в которой компонент был размещен первоначально.

Пример размещенного компонента с отображением свойств выделенной контактной площадки компонента и присвоенными параметрами стека контактных площадок представлен на <u>Рис. 39</u>.







Рис. 39 Отображение параметров стека КП компонента

При перемещении компонента в область другого стека печатной платы необходимо выполнить переразмещение данного компонента.

Процедура переразмещения обеспечит обновление параметров стека КП компонента.

Пример компонента, перемещенного в область другого стека печатной платы, с отображением свойств выделенной контактной площадки компонента и присвоенными параметрами стека контактных площадок до выполнения процедуры переразмещения представлен на <u>Рис. 40</u>.



Рис. 40 Отображение параметров стека КП перемещенного компонента

Для переразмещения компонента выберите компонент и в контекстном меню компонента нажмите «Переразместить», см. <u>Рис. 41</u>.







Рис. 41 Переразмещение компонента

Пример переразмещенного компонента с отображением обновленных параметров стека КП представлен на <u>Рис. 42</u>.

4			
	🏂 Свойства		
	XS5.4 (Ko	нтактная площадка)	
	Q Поиск		
	∨ Общие		
	Обозначение	XS5	
	Номер КП	4	
	Контакт	4	
	Имя цепи		
	Стиль КП	Through	~
	Название КП	Pad_PLS	
	Задержка (нС)	0	
	Выделенная длина	0	
	∨ Стек КП		
	Signal 1	Round 1.6	
	Signal 2	Round 1.6	
	DRILL	Round 1	
	L		
	Выд	целен 1 объект	

Рис. 42 Отображение параметров стека КП переразмещенного компонента

В случае если компонент был перемещен из первоначальной области стека в другую область стека печатной платы, но переразмещение компонента не производилось, DRC-проверка компонента выявит нарушения, см. <u>Рис. 43</u>.





Списо	ок ошибок (43,0,0)		□ ×
! Ош	ибок : 43	🛕 Предупреждений : 0 🛛 () Сообщений : 0 🖓 🔚 🗎	Текущий редактор	Последняя проверка
Тип	Плата	Описание ↑		
1	ГЖПП_2	Стек "Жесткий" контактной площадки XS5.1 не совпадает со стеком "Гибкий" части платы		-
!	ГЖПП_2	Стек "Жесткий" контактной площадки XS5.1 не совпадает со стеком "Гибкий" части платы		
!	ГЖПП_2	Стек "Жесткий" контактной площадки XS5.2 не совпадает со стеком "Гибкий" части платы		
!	ГЖПП_2	Стек "Жесткий" контактной площадки XS5.2 не совпадает со стеком "Гибкий" части платы		
!	ГЖПП_2	Стек "Жесткий" контактной площадки XS5.3 не совпадает со стеком "Гибкий" части платы		
1	гжпп_2	Стек "Жесткий" контактной площадки XS5.3 не совпадает со стеком "Гибкий" части платы		
1	гжпп_2	Стек "Жесткий" контактной площадки XS5.4 не совпадает со стеком "Гибкий" части платы		
1	ГЖПП_2	Стек "Жесткий" контактной площадки XS5.4 не совпадает со стеком "Гибкий" части платы		
4				

Рис. 43 Сообщения об ошибках нессответствия стеков КП

8 DRC

При работе с гибко-жесткой конструкцией печатной платы в системе существует возможность настройки правил проектирования для отдельных стеков платы, а для контроля правильности создания конструкции предусмотрены дополнительные проверки.

Переход к проверке платы осуществляется из главного меню «Инструменты» → «Проверка платы (DRC)», см. <u>Рис. 44</u>.



Рис. 44 Переход к проверке платы

В окне «Проверка правил DRC» отображен весь перечень выполняемых проверок для созданной печатной платы. Для проверки гибко-жесткой конструкции предусмотрены дополнительные пункты «Гибкая часть платы» и «Контур платы». Пример отображения выполненных проверок представлен на Рис. 45.





Название		Завершено	Время	Примечание	
🖌 🛷 Т-соединени	9	100%	00:00.054		
🖌 🛷 Длина пин-па	іры	100%	00:00.000		
🖌 🎻 Корректност	• ПО по слоям	100%	00:00.078		
🖌 🎻 кп - кп		100%	00:00.404		
🖌 🎻 кп - по		100%	00:00.095		
🖌 🎻 по - по		100%	00:00.032		
🖌 🛷 Закольцован	ные соединения	100%	00:00.067		
🖌 🎻 Незавершенн	ые цепи	100%	00:00.035		
🖌 🎻 Незавершенн	ый трек	100%	00:00.082		
🖌 🎻 Контур плать	I	100%	00:00.248		
🖌 🛷 Гибкая часть	платы	100%	00:00.430		
🖌 🛷 Не размещен	ные компоненты	100%	00:00.000		
🖌 🛷 Связь вывода	а с КП	100%	00:00.000		
🖌 🛷 Объекты соо	гветствуют технологии	100%	00:00.000		
🖌 🛷 Пересечение	границ корпусов	100%	00:00.017		

Рис. 45 Окно «Проверка правил DRC»

В редакторе правил учитывается работа со всеми созданными стеками печатной платы, для каждого стека гибко-жесткой конструкции могут быть заданы свои правила проектирования.

Определение правил проектирования происходит в окне редактора «Правила». Переход в данный редактор осуществляется с помощью команды контекстного меню «Открыть», вызванной для узла «Правила» в дереве проекта, см. <u>Рис. 46</u>.

🛱 Проекты	
600	
🔍 Искать в проектах	
〜 圓 SmartWatch (ГЖПП)	
> °t° Состав	
В Правила Открыть	
🗸 🖹 Документы	
🗘 Схема	
🗐 Плата	1
> 🔝 Отчёты	
> 📋 Расчёты и анализы	
> 🖹 Файлы	
> 📮 Библиотека	

Рис. 46 Переход к правилам проекта

Настройка правил проектирования для стеков печатной платы осуществляется с помощью указания области действия правила в виде необходимого стека, см. <u>Рис. 47</u>.





💷 SmartWa	atch (ГЖПП) * × 🚏 SmartWatch (ГЖПП)	• ×					
<pre>1 Clearance: (Any; Any) on (Stack="New Stackup1") = {MinWidth:0.1; NominalWidth:1} 2 Allow: (ISTrack ISVia IS</pre>							
			Помощник формарования правил	УК ЛК			
Зазоры							
Объект 1:	Любой	∨ Цепь 1:	Любая 🗸	Добавить Очистить			
Объект 2:	Любой	∨ Цепь 2:	Любая ~	Добавить Очистить			
Область:	Любой слой	~	Любой стек	Добавить Очистить			
Минимальн	ный зазор: 0,1 🗘 Номинальный зазор:	1 \$	 Выбрать все) Stack="Default" ✓ Stack="New Stackup1" ОК Отмена 				
Комментар	Комментарии: //						
Правило: Зазоры Удалить Вверх Вниз 1							

Рис. 47 Выбор стека в качестве области действия правила

Список правил, для которых существует возможность выбрать стек как область действия правила:

- Ширина треков;
- Параметры дифференциальных пар;
- Зазоры между объектами разных цепей и одной цепи;
- Ширина гарантийного пояска;
- Разрешенные стили переходных отверстий;
- Разрешение установки ПО на КП;
- Запреты на размещение объектов цепи;

Подробное описание работы с правилами проектирования представлено в документе Редактор правил.

9 Трассировка

9.1 Интерактивная трассировка

Трассировка гибко-жесткой конструкции печатной платы осуществляется в режиме RightPCB.





Функциональные особенности трассировки гибко-жесткой конструкции:

- Размещение треков (проводников) осуществляется на сигнальных слоях областей платы. При переходе проводника из области одного стека в область другого стека печатной платы необходимо учитывать наличие в нем данного слоя.
- 2) При размещении треков на переходе между жестким и гибким стеками, треки должны быть ортогональны переходу.
- 3) При размещении треков в районе сгиба треки должны быть перпендикулярны линии сгиба.

9.2 Переходные отверстия

При размещении переходного отверстия на плате ему автоматически присваивается стиль, заданный для стека платы.

При перемещении переходного отверстия в область другого стека, стиль не изменится, а проверка данного элемента выявит ошибку.

Пример отображения ошибки для перемещенного в область другого стека платы переходного отверстия представлен на <u>Рис. 48</u>.



Рис. 48 Проверка перемещенного ПО

Изменение стиля переходного отверстия производится в панели «Свойства» → «Стиль VIA», см. <u>Рис. 49</u>.







Рис. 49 Изменение стиля ПО

10 Подготовка к производству

10.1 Создание слоя маски

Для создания защитной маски на гибком участке печатной платы реализован специальный инструмент «Заменить маску и пасту». Переход к данному инструменту осуществляется из главного меню программы «Инструменты» — «Заменить маску и пасту», см. <u>Рис. 50</u>.

₽ 0	Проверка платы (DRC)			
5	SimPCB			
68	Поиск объектов	Ctrl+F		
	Фанауты		>	
	Граница платы		>	
	Область металлизации		>	
	Регион		>	
8	Заменить маску и пасту			
	Натяжение треков	F5		
7	Скругление треков			
	Удалить трассировку			
	Сохранить как новый вариант платы			
ail	Статистика проекта			
F	Измерить расстояние			
	Перенести	м		
100	Переместить начало координат			
Рис. 50 Главное меню программы				

Также данный инструмент доступен на панели инструментов «Плата», см. <u>Рис. 51</u>.







Рис. 51 Панель инструментов «Плата»

После выбора инструмента на экране отобразится окно «Заменить маску и пасту». В случае если плата содержит гибкую часть, в данном окне будут доступны настройки по замене маски на гибкой части, см. <u>Рис. 52</u>.

🕽 Заменить маску и пасту (на всей плате) — 🗆 🗙
MACKA
Задать отступ для маски: 0 ММ УТОР ВОТТОМ
🦳 Удалить маску
Использовать маску КП из библиотеки
Иаска на гибкой части
🗹 Задать отступ для маски: 🛛 🗘 мм 🗹 ТОР 🗹 ВОТТОМ
Удалить маску
Использовать маску КП из библиотеки
📃 Маска на выбранных ПО
🖉 Задать отступ для маски: 🛛 🗘 мм 💟 ТОР 💟 ВОТТОМ
Удалить маску
ПАСТА
Для планарных КП П Для сквозных КП
🗹 Задать отступ для пасты: 🛛 0 🛟 мм 🗹 ТОР 🗹 ВОТТОМ
Удалить пасту
Использовать пасту КП из библиотеки
ОК Отмена

пасту»

10.2 Экспорт производственных файлов

Описание процесса создания производственных файлов представлено в документе Выпуск документации.

Пример отображения конструкции печатной платы, для которой создаются производственные файлы, представлен на рисунке <u>Рис. 53</u>.







Рис. 53 Гибко-жесткая конструкция из двух стеков

Экспорт производственных файлов печатной платы происходит при помощи мастера экспорта производственных файлов. Запуск мастера экспорта осуществляется из контекстного меню печатной платы в дереве проектов, см. Рис. 54.

🔁 Проекты			
600			
 Искать в проектах 			
🗸 🗐 Частотный усилит	ель (4-х лучевой)(ГЖПП)		
> °t8 Состав			
88° Правила			
🗸 📔 Документы			
🗘 Схема			
🗐 Плата	Открыть		
> 🔓 Отчёты	Создать	>	
🗲 📔 Расчёты и ана	Олои и переходные отверстия		
> 📄 Файлы	Открыть 3D модель		
> 📮 Библиотека	Создать шаблон на основе плат	ы	
	Создать шаблон правил из плат	ы	
	Экспорт	>	Экспорт Р-САД (РСВ)
	🌫 Свойства	Ctrl+Enter	DXF
			KOMПAC-3D
			IDF
			PDF
			Файлы производства (GBR, DRL, IPC356A)
			000++

Рис. 54 Вызов мастера экспорта производственных файлов

Для гибко-жесткой конструкции возможно создание производственного файла с общим контуром платы, а также отдельных файлов с контурами печатной платы для каждого стека. Для создания необходимого набора файлов установите флаги в чек-боксы для нужных слоев в окне мастера экспорта, см. <u>Рис. 55</u>.





	🔲 Слой		Имя файла		Расширен	Описание	Х-зерк.	Ү-зерк.	Нега	
Начальная настройка	Покровная ТОР		Покровная ТОР		abr	маска, нижний				-
Настройка экспорта файлов	Покровная ВОТ		Покровная_ВОТ		gbr	маска, нижний				
	SOLDERMASK BOTTOM		SOLDERMASK BOTT		gbr	маска, нижний				
настроика экспорта фаилов сверловки	DOCUMENTUM	DOCUMENTUM		DOCUMENTUM		документирую				
Настройка экспорта файлов электроконтроля	BOARD_OUTLINE	BOARD_OUTLINE		D_OUTLINE gbr		граница платы				٦
Настройки сохранения	BOARD_OUTLINE_	Rigid	BOARD_OUTL	NE_Rigid	gbr граница плать					
Создание файлов	BOARD_OUTLINE_Flex		BOARD_OUTLINE_Flex		gbr	граница платы,				
	PLACEMENT_OUT	LINE_T	PLACEMENT	OUTLIN	gbr	габариты комп				
	PLACEMENT_OUT	LINE_B	PLACEMENT	OUTLIN	gbr	габариты комп				
	Выбрано 3/20				PA3MEC	ТИТЬ НА СЛОЯХ ШЕ	ЕЛКОГРАФ	ии		
	Единицы измерения:	Миллимет	ры 🗸		🗸 Ат	рибуты компонентов	3 (Ì)			
	Версия Gerber:	X1 (RS 274	X) ~		🔽 Пр	очий текст	i			
	Формат чисел:	4 🗘	4 \$	(i)						
	Отображение нулей:	Полное	~	i						

Рис. 55 Создание файлов производства

Количество производственных файлов зависит от количества выбранных слоев для экспорта. Названия файлов соответствуют названиям стеков и присваиваются автоматически, см. <u>Рис. 56</u>.

Cutput	× +			- 1	
\leftarrow \rightarrow \uparrow (🖯 🖵 > Докум	менты > Delta Design	> Output	Поиск в: Outp	out Q
🛨 Создать - 🔏	0 10 4	🖻 🔟 🔨 Сорт	ировать – •••		Сведения
🔨 Главная	NN I	^ RM	Дата изменения	Тип	
🔁 Галерея	В	BOARD_OUTLINE.gbr	17.02.2025 10:56	Файл '	"GBR"
	В	BOARD_OUTLINE_Flex.gbr	17.02.2025 10:56	Файл '	"GBR"
	В	30ARD_OUTLINE_Rigid.gbr	17.02.2025 10:56	Файл '	"GBR"
Рабочий стол	*				
Элементов: 3					
Puc. 56 O	тображение	е созданных ф проводнике	райлов произе	зодства	6

На рисунках <u>57</u> - <u>59</u> представлены: общий контур печатной платы, контуры жесткого и гибкого стеков.







Рис. 57 Просмотр производственных файлов. Общий контур печатной платы



Рис. 58 Просмотр производственных файлов. Контур жесткого стека «Rigid»





😂 Слои	× ×	Cutput * X
🔲 Только текущий слой		🚯 🔓 Режим выбора
V 🗹 Output		mm -20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300
BOARD_OUTLINE		
BOARD_OUTLINE_Rigid		
BOARD_OUTLINE_Flex		
> Служебные		
		2

Рис. 59 Просмотр производственных файлов. Контур гибкого стека «Flex»

11 Ограничения

Функциональные возможности по созданию гибкой и гибко-жесткой конструкций доступны только в профессиональной версии системы Delta Design.

При работе с гибко-жесткими конструкциями в системе Delta Design имеется ограничение на использование режима «TopoR». Если разрабатываемая конструкция платы содержит больше одного стека, то переход в данный режим невозможен.







Цель компании ЭРЕМЕКС – создание эффективной и удобной в эксплуатации отечественной системы, реализующей сквозной цикл автоматизированного проектирования радиоэлектронной аппаратуры.

Система Delta Design – это обобщение мирового опыта в области автоматизации проектирования, а также разработка оригинальных моделей и алгоритмов на основе нетрадиционных подходов к решению сложных задач.

Компания ЭРЕМЕКС благодарит Вас за интерес, проявленный к системе Delta Design, и надеется на долговременное и плодотворное сотрудничество.

